

歷史、發展及公司架構

概覽

本集團的歷史可追溯至2001年8月，當時本公司的前身由我們的創始人Wayne Wei-Ming Dai博士透過Celestry Design Technologies, Inc.在中國成立，名為思略微電子(上海)有限公司，其後於2002年7月更名為芯原微電子(上海)有限公司。於2019年3月，本公司改制為股份有限公司，並更名為芯原微電子(上海)股份有限公司。於2020年8月，本公司A股於上海證券交易所科創板上市，股份代號為688521。

經過多年業務發展，我們已成為一家領先的芯片定制解決方案上市公司，且擁有全面、專有的半導體IP組合。

主要公司及業務發展里程碑

下文為本集團主要公司及業務發展里程碑概要：

年份	里程碑
2001	本公司的前身於2001年8月在中國上海成立。
2002	我們開始為晶圓代工廠設計標準單元庫IP。
2003	我們於美國聖荷西設立銷售辦事處及研發中心，並於中國台北設立銷售辦事處。
2004	我們收購了眾華科技(香港)有限公司及其附屬公司上海眾華電子有限公司。 我們開始提供芯片定制服務。
2005	我們成為LSI在中國內地認證的首家ZSP設計中心。
2006	我們收購了LSI Logic公司的DSP部門，並將DSP IP加入我們的IP組合。 我們在日本東京及法國尼斯設立我們的銷售辦事處，並在美國達拉斯設立研發中心。
2007	我們於北京設立銷售辦事處及研發中心，並於韓國首爾設立銷售團隊。 我們獲得PowerPC授權。
2009	我們基於IBM工藝設計了一款網絡交換芯片。
2010	我們在德國慕尼黑設立銷售團隊。 我們成為谷歌WebM視頻格式在亞洲的首家硬件合作夥伴。
2011	我們在深圳及香港設立我們的銷售辦事處。
2013	我們在成都設立研發中心。
2014	我們增加了面向FD-SOI的IP設計和芯片定制服務。 我們收購了虹軟的軟件開發團隊和圖像視覺技術。

歷史、發展及公司架構

年份	里程碑
2016	<p>我們收購了Vivante Corporation，並將GPU IP加入我們的IP組合。</p> <p>我們實現了基於22納米FD-SOI和14納米FinFET工藝節點的芯片設計及流片。</p>
2017	<p>我們將NPU IP、BLE IP和NB-IoT IP加入我們的IP組合。</p>
2018	<p>我們將ISP IP加入我們的IP組合。</p> <p>我們實現了基於7納米FinFET工藝節點的芯片設計及流片。</p> <p>我們牽頭成立了中國RISC-V產業聯盟。</p>
2019	<p>我們開始進行Chiplet技術的研發。</p>
2020	<p>我們為處理器IP增加了FLEXA API。</p> <p>本公司於上海證券交易所科創板上市，被譽為「中國半導體IP第一股」。</p> <p>我們在南京及海口設立我們的研發中心。</p>
2021	<p>我們的ISP IP獲得ISO 26262車輛功能安全認證。</p> <p>我們實現了基於5納米FinFET工藝節點的芯片設計及流片。</p> <p>我們完成了第一代數據中心視頻轉碼平台的研發。</p> <p>我們在美國奧斯汀設立銷售辦事處，並在上海臨港設立研發中心，與上海張江形成雙研發中心版圖。</p> <p>我們成為Alphawave在中國內地、香港及澳門的獨家銷售合作夥伴。</p> <p>我們將顯示處理IP加入我們的IP組合。</p>
2022	<p>我們推出了創新型人工智能圖像增強技術AI-ISP。</p> <p>我們推出了功能安全(FuSa) SoC設計平台。</p> <p>我們的芯片設計流程獲得ISO 26262認證，我們的ISP IP獲得IEC 61508工業功能安全認證。</p> <p>我們加入了UCIe產業聯盟。</p>
2023	<p>我們發佈了2022年年報，實現全年盈利，並成功為股份簡稱「摘U」。</p> <p>我們與微軟合作在邊緣設備上部署Windows 10操作系統，並與谷歌就開源項目Open Se Cura進行合作。</p> <p>我們推出了面向智能顯示設備的超分辨率技術。</p> <p>我們的低功耗藍牙完整解決方案獲得藍牙5.3認證。</p>

歷史、發展及公司架構

年份	里程碑
2024	<p>我們在越南胡志明市設立研發中心。</p> <p>我們推出了面向數據中心的新一代VPU IP和高性能 Vitality 架構GPU IP。</p> <p>內置我們NPU IP的AI芯片全球出貨量超過1億顆。</p> <p>我們完成了第二代視頻轉碼平台的研發。</p> <p>我們的顯示處理IP和畸變校正處理器IP獲得ISO 26262認證。</p> <p>我們牽頭成立了上海開放處理器產業創新中心。</p>
2025	<p>我們完成A股定向增發，募集所得款項淨額約人民幣17.8億元。</p> <p>我們訂立協議，通過本公司牽頭的特殊目的實體收購逐點半導體。</p> <p>我們在廣州設立研發中心。</p> <p>我們與谷歌聯合推出了開源Coral NPU IP。</p> <p>我們向一家領先的新能源汽車廠商交付了一款定製的5納米車規級自動駕駛芯片。</p> <p>內置我們GPU IP的客戶芯片全球出貨量超過20億顆。</p> <p>內置我們NPU IP的AI芯片全球出貨量接近2億顆。</p> <p>我們的NPU IP獲得ISO 26262認證。</p>

我們的重大附屬公司

下表載列於往績記錄期間我們認為對我們的營運屬重大及／或對我們的財務表現作出重大貢獻的本公司主要附屬公司的詳細資料。

附屬公司名稱	註冊成立/ 成立地點	註冊成立/ 成立日期	本集團 應佔股權 權益	主要業務活動
芯原微電子(北京)有限公司(「芯原北京」)...	中國	2007年6月13日	100%	技術研發
芯原微電子(成都)有限公司(「芯原成都」)...	中國	2013年4月28日	100%	技術研發

歷史、發展及公司架構

附屬公司名稱	註冊成立/ 成立地點	註冊成立/ 成立日期	本集團 應佔股權 權益	主要業務活動
圖芯芯片技術(上海)有限公司(「圖芯上海」) ⁽¹⁾ ...	中國	2007年6月7日	100%	技術研發
芯原微電子(南京)有限公司(「芯原南京」)....	中國	2020年5月8日	100%	IP授權、芯片定制及 技術研發
芯原微電子(海南)有限公司(「芯原海南」)....	中國	2020年12月17日	100%	技術研發
芯原科技(上海)有限公司(「芯原科技」)....	中國	2021年10月29日	100%	IP授權、芯片定制及 技術研發
芯原微電子(廣州)有限公司(「芯原廣州」)....	中國	2025年9月4日	100%	IP授權、芯片定制及 技術研發
VeriSilicon Holdings Co., Ltd (「芯原開曼」).....	開曼群島	2002年6月10日	100%	投資控股
VeriSilicon, Inc.	美國	2003年2月14日	100%	IP授權、芯片定制及 技術研發
芯原(香港)有限公司 (「芯原香港」).....	香港	2011年11月9日	100%	芯片定制
Vivante Corporation ⁽¹⁾	美國	2002年4月2日	100%	IP授權及技術研發

附註：

(1) Vivante Corporation及圖芯上海由本集團收購，並自2016年1月起成為我們的全資附屬公司。

公司發展及主要股權變動

1. 本公司註冊成立

於2001年8月21日，本公司的前身思略微電子(上海)有限公司根據中國法律成立為有限責任公司，由Celestry Design Technologies, Inc.出資，初始註冊資本為500,000美元，其後於2002年7月更名為芯原微電子(上海)有限公司。於最後實際可行日期，Celestry Design Technologies, Inc.為一名獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

2. 改制為股份有限公司

經多輪增資及股權轉讓後，截至2019年3月，本公司的註冊資本達到45,013,418美元。於2019年3月26日，本公司改制為股份有限公司，並更名為芯原微電子(上海)股份有限公司。

改制完成後，本公司的註冊資本為人民幣369,000,000元，分為369,000,000股，每股面值人民幣1.00元的股份，本公司的股權架構如下：

股東名稱	持有 股份數目	股權 概約百分比
VeriSilicon Limited ⁽¹⁾	77,876,777	21.10%
富策控股 ⁽²⁾	41,835,619	11.34%
國家集成電路基金 ⁽²⁾	34,724,272	9.41%
嘉興時興 ⁽²⁾	26,279,585	7.12%
嘉興海橙 ⁽²⁾	22,046,654	5.97%
Wayne Wei-Ming Dai 博士 ⁽³⁾	6,996,565	1.90%
境內員工持股平台 ⁽⁴⁾	1,837,778	0.50%
共青城文興 ⁽²⁾	128,767	0.03%
其他25名股東 ⁽⁵⁾	157,273,983	42.62%
總計	369,000,000	100%

附註：

- (1) VeriSilicon Limited為我們的境外員工持股平台。
- (2) 於最後實際可行日期，各該等股東均為獨立第三方。
- (3) Wayne Wei-Ming Dai 博士於表中所示持有的股份數目不包括彼透過我們的境外員工持股平台 VeriSilicon Limited 持有的間接權益。
- (4) 該等員工持股平台包括於中國成立的合共九家有限合夥企業。
- (5) 於最後實際可行日期，該25名股東各自持有本公司當時總股本的不足5%，且均為獨立第三方。

3. 於上海證券交易所科創板上市

經中國證監會批准，本公司於2020年8月18日完成於上海證券交易所科創板(股份代號：688521)的A股首次公開發售及上市(「A股上市」)，據此合共新發行48,319,289股A股。緊隨A股上市後，我們的註冊資本增至人民幣483,192,883元。

4. A股私募配售

於2025年6月，我們完成向合共11名機構投資者(各自均為獨立第三方)私募配售24,860,441股A股，價格為每股A股人民幣72.68元，乃參考定價日期前20個交易日我們A股的平均收市價釐定。我們自該私募配售籌得所得款項淨額約人民幣17.8億元，用於AIGC及智慧出行領域Chiplet解決方案平台的研發和面向AIGC、圖形處理的新一代IP研發及產業化。由於該私募配售，我們的總股本增至人民幣525,713,273元。

歷史、發展及公司架構

股份激勵計劃

於我們的A股上市前，本集團於2019年6月批准2019年股票期權激勵計劃（「**2019年期權計劃**」），據此，合共授出21,363,300股股票期權。2019年期權計劃已於2022年7月到期。

為進一步完善本集團的長效激勵機制，吸引及留住優秀人才，充分調動本集團員工的積極性，自A股上市以來，我們已採納合共三項限制性A股激勵計劃。詳情請參閱本文件「附錄四—法定及一般資料—限制性A股激勵計劃」。

重大收購、出售及合併

收購逐點半導體

於2025年10月，天遂芯願科技(上海)有限公司（「**天遂芯願**」）由本公司成立，初始註冊資本為人民幣10百萬元，作為收購逐點半導體(上海)股份有限公司（「**逐點半導體**」）全部股權的特殊目的公司（「**收購逐點半導體**」）。逐點半導體專注於開發及設計移動視覺處理芯片、視頻轉碼芯片、3LCD投影儀芯片及實施解決方案。

於2025年10月15日，天遂芯願與逐點半導體及其當時的股東訂立股權購買協議，據此，天遂芯願同意收購而逐點半導體的所有股東（本公司除外）同意出售逐點半導體97.89%的股權，代價為人民幣930百萬元現金另加交易費用及其他相關開支。據本公司董事作出一切合理查詢後所深知，逐點半導體當時的各股東（本公司除外）均為獨立第三方。緊接該股權購買協議交割前，本公司直接擁有逐點半導體2.11%的股權。

於2025年12月12日，天遂芯願、本公司、華芯鼎新(北京)股權投資基金(有限合夥)（「**華芯鼎新**」）、上海國投先導集成電路私募投資基金合夥企業(有限合夥)（「**國投先導**」）、北京屹唐元創股權投資基金合夥企業(有限合夥)（「**屹唐元創**」）、北京芯創智造二期創業投資基金(有限合夥)（「**芯創智造**」）及上海涵澤創業投資合夥企業(有限合夥)（「**涵澤創投**」），連同華芯鼎新、國投先導、屹唐元創及芯創智造，統稱「**其他買方**」訂立增資協議，據此，(i)本公司同意分別以其持有的逐點半導體2.11%股權為代價認購天遂芯願人民幣20百萬元的新增註冊資本，及以現金代價人民幣350百萬元認購天遂芯願人民幣350百萬元的新增註冊資本，及(ii)華芯鼎新、國投先導、屹唐元創、芯創智造及涵澤創投同意分別以現金代價人民幣300百萬元、人民幣150百萬元、人民幣50百萬元、人民幣50百萬元及人民幣20百萬元認購天遂芯願人民幣300百萬元、人民幣150百萬元、人民幣50百萬元、人民幣50百萬元及人民幣20百萬元的新增註冊資本。據本公司董事作出一切合理查詢後所深知，其他各買方均為獨立第三方。緊隨增資後，天遂芯願由本公司、華芯鼎新、國投先導、屹唐元創、芯創智造及涵澤創投分別持有40%、31.58%、15.79%、5.26%、5.26%及2.11%的權益，天遂芯願的註冊資本增至人民幣950百萬元。

上述收購已於2026年1月妥善合法完成，並已取得所有必要的監管批准。收購逐點半導體完成後，逐點半導體由天遂芯願全資擁有，而天遂芯願則由本公司

歷史、發展及公司架構

擁有40%權益。由於本公司根據上述協議控制天遂芯願董事會的組成，於收購逐點半導體完成後，逐點半導體成為本公司的附屬公司，其業績將合併至本集團的財務報表。

擬收購芯來智融

於2025年8月28日，本公司與胡振波、芯來共創(上海)管理諮詢中心(有限合夥)及芯來合創(上海)管理諮詢中心(有限合夥)訂立股權收購意向書，據此，本公司擬透過發行股份及支付現金的方式購買芯來智融半導體科技(上海)股份有限公司(「芯來智融」)的股份並募集配套資金(「擬收購芯來智融」)。於2025年9月11日，擬收購芯來智融獲董事會批准。然而，由於芯來智融管理層及交易對手方提出的核心訴求及關鍵事項偏離市場環境、監管要求以及本公司及其全體股東的利益，在收到芯來智融管理層及交易對手方終止該交易的通知後，董事會於2025年12月11日批准終止擬收購芯來智融。

除上文所披露者外，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無進行任何重大收購、出售或合併。

我們於上海證券交易所科創板上市及於香港聯交所[編纂]的理由

自2020年8月起，本公司A股已於上海證券交易所科創板上市。於最後實際可行日期，我們的董事確認，我們在任何重大方面概無不遵守上海證券交易所科創板規則及中國其他適用證券法律法規的情況，且據董事經作出一切合理查詢後所深知，概無有關我們在上海證券交易所科創板的合規記錄而須提請投資者垂注的重大事宜。我們的中國法律顧問告知我們，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們不存在被中國證監會及其派出機構或上海證券交易所處以重大行政處罰或被採取重大監管措施的情況，且我們已在重大方面符合適用於我們的A股上市相關法律法規。根據聯席保薦人進行的獨立盡職調查，聯席保薦人並無注意到任何事宜會令彼等不同意我們的董事就本公司於上海證券交易所科創板的合規記錄作出的確認。

本公司尋求其H股於香港聯交所[編纂]，旨在進一步推動本公司的國際化戰略、提升本公司的國際品牌形象、增強本公司的核心競爭力，以及提升本公司的營運及管理水平。詳情請參閱「業務—我們的戰略」及「未來計劃及[編纂]用途」。

擬全球預託證券申請

經董事會於2023年3月3日及本公司股東於2023年3月20日批准，我們建議在全球發售本公司全球預託證券(「全球預託證券」)並將全球預託證券於瑞士證券交易所上市(「建議全球預託證券申請」)。上市申請其後於2023年3月提交予瑞士證券交易所，並於2023年5月獲得瑞士證券交易所的有條件批准。然而，經考慮整

歷史、發展及公司架構

體宏觀經濟狀況，我們已於2023年12月終止發售全球預託證券。於我們籌備建議全球預託證券申請期間，我們並無遇到任何重大困難或法律障礙導致我們終止籌備建議全球預託證券申請。

經我們的董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，我們的董事並不知悉任何有關建議全球預託證券申請的重大事宜，可能對本公司於聯交所[編纂]H股的合適性造成重大不利影響，且須提請聯交所、其股東或潛在投資者垂注。

根據聯席保薦人進行的獨立盡職調查工作以及向聯席保薦人提供的資料及文件，聯席保薦人並無注意到任何事宜可合理地質疑上文所載董事的意見。

公眾持股量及自由流通量

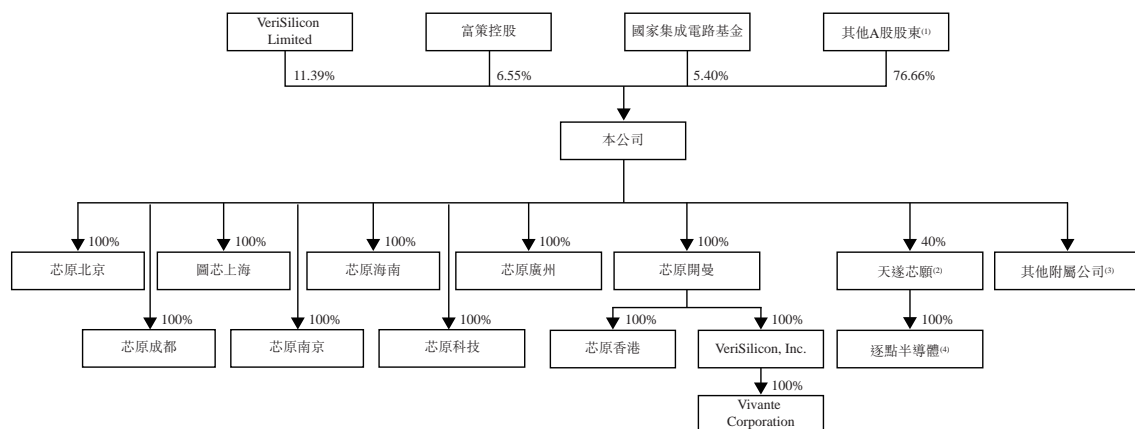
上市規則第19A.13A條規定，倘新申請人為於上市時擁有其他上市股份的中國發行人，通常指於上市時，申請上市的H股中由公眾人士持有的部分必須(a)佔發行人H股所屬類別已發行股份總數(不包括庫存股份)的至少10%；或(b)預期[編纂]不低於3,000,000,000港元。

我們的A股於上海證券交易所科創板上市。預期於[編纂]後(假設[編纂]未獲行使且概無根據限制性A股激勵計劃發行額外股份)，根據每股H股[編纂][編纂]港元(即指示性[編纂]範圍的低端)，公眾持有的H股[編纂]約為[編纂]港元，高於上市規則第19A.13A(2)條規定的公眾須持有H股的規定[編纂]30億港元，從而符合上市規則第8.08(1)條(經上市規則第19A.13A條修訂及取代)的規定。

按每股H股[編纂][編纂]港元(即指示性[編纂]範圍的低端)計算，本公司將符合上市規則第8.08A條(經上市規則第19A.13C條修訂及取代)項下的自由流通量規定。

緊接[編纂]完成前的公司架構

下圖說明我們緊接[編纂]前的公司及股權架構：



附註：

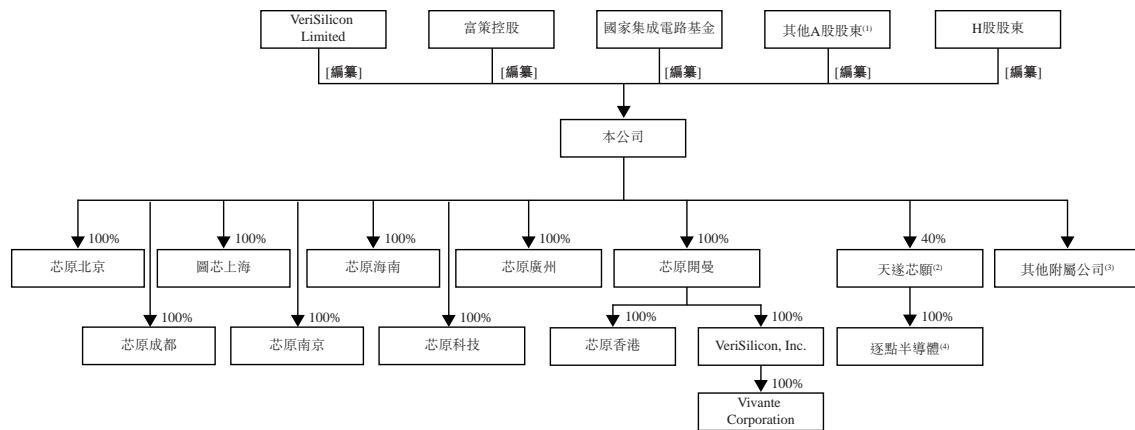
- (1) 截至最後實際可行日期，本公司持有287,000股A股作為庫存股份，該等股份不附帶任何股東權利，包括但不限於股東大會投票權及股息權。

歷史、發展及公司架構

- (2) 於最後實際可行日期，天遂芯願由本公司持有40%，並由華芯鼎新、國投先導、屹唐元創、芯創智造及涵澤創投分別持有31.58%、15.79%、5.26%、5.26%及2.11%（均為獨立第三方）。
- (3) 截至最後實際可行日期，其他附屬公司為本公司間接全資擁有的其他四家海外附屬公司，包括芯原電子(香港)有限公司、VeriSilicon Vietnam Company Limited、VeriSilicon Kabushiki Kaisha及VeriSilicon EURL。
- (4) 逐點半導體直接持有逐點半導體(珠海)有限公司100%股權。
- (5) 上圖所載若干百分比數字已作四捨五入調整。

緊隨[編纂]完成後的公司架構

下圖說明我們緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使且概無根據限制性A股激勵計劃發行額外股份)的公司及股權架構：



附註： 有關進一步資料，請參閱上文「緊接[編纂]完成前的公司架構」一段的附註(1)至(5)。